

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-021

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/1/24
回购方案实施期限	2024年1月23日~2024年4月22日
预计回购金额	13,000万元~20,000万元
回购用途	为维护公司价值及股东权益、用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	2,331,570股
累计已回购股数占总股本比例	3.886%
累计已回购金额	15,908.1955万元
实际回购价格区间	60.21元/股~74.98元/股

一、回购股份的基本情况

2024年1月23日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。另，公司于2024年2月1日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以不超过人民币75元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。公司拟用于回购股份的资金总额不低于13,000万元（含），不高于20,000万元（含），回购股份的45%（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激励之用途，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励。回购期限为自第二届董事会第二次会议审议通过变更前的回购股份方

案之日起不超过 3 个月。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下：

自 2024 年 2 月 1 日首次实施回购以来，截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,331,570 股，占公司当前总股本的比例为 3.886%，回购成交的最高价为 74.98 元/股，最低价为 60.21 元/股，已支付的总金额为 159,081,955 元（不含交易费用）。上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 2 日